PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-168368

(43) Date of publication of application: 22.06.2001

(51)Int.CI.

H01L 31/042 H01R 9/22 H02G 3/16 H02G 15/16

(21)Application number: 11-349774

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

09.12.1999

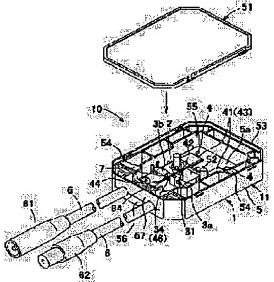
(72)Inventor: KONDO YUZURU

(54) TERMINAL BOX

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a terminal box which can maintain the heat radiating property of a bypass diode while securing a specified diode capacity under a high temperature environment.

SOLUTION: A thin bare chip 2 is used as a bypass diode. The bare chip 2 is held between overlapping parts 31 of a set of two conductive metal thin plates fastened to respective relay terminals and extended between these relay terminals in such a manner as to face each other, to form a bypass circuit structure 7. When supplying a specified necessary amount of current to the bypass circuit, a cross-sectional area of each conductive metal thin plate and a joint area of each conductive metal thin plate with a corresponding electrode layer are so set that the surface temperature of the bare chip with the following changes in temperature considered may be the thermal destruction temperature or below: the temperature change elements include at least (A) a change of the ambient temperature of the bare chip based on the influence by the sun beam, the temperatures of roof



tiles or the like, (B) the increase in temperature of the bare chip itself based on the generation of heat by conduction, and (C) the decrease in heat radiation temperature of the bare chip based on the thermal conduction through the conductive metal thin plates joined to the upper and lower electrode layers.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發导 特開2001-168368 (P2001-168368A)

(43)公開日 平成13年6月22日(2001.6.22)

(51) Int.CL'		織別記号	FΙ			ラーマ	フー/ (参考)
HOIL	31/042		HOIR	9/22		. 1	5E086
H01R	9/22		H02G	3/16		z :	5F051
H02G	3/16		Į!	5/16	•	1	5G361
	15/16		HOIL 3	1/04		R £	5 G 3 7 5
•			北路连由	來翻求	菌求項の数 5	OL	(全 11 頁)
(21) 山鰯番号	}	特國平11-349774	(71)出頃人		31		
(22)出庭日		平成11年12月9日(1989.12.9)			工業株式会社 版化北区中之。		目2番4号

(72) 発明者 近藤 譲 兵庫県芦屋市精道町6-17-303 (74)代型人 100074561

弁理士 抑斯 陸至

Fターム(参考) 55086 OCL2 OC46 OC50 DD09 DD33

DD49]]28 LLO4 LL17 LL20

5F051 BA03 BA18 EA17 JA07 JA08 5G361 BAO7 BB01 BC01 BC03

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

5G375 AAG2 BA26 BB48 CAG2 CA12

CA17 CB03 CB10 CC07 CC10

DA36 D826 D844

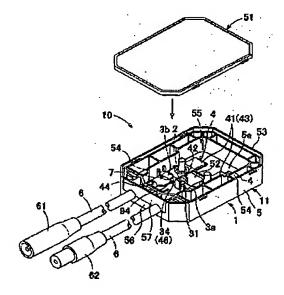
(54) 【発明の名称】 端子ポックス

(57)【要約】

【課題】 バイバスダイオードの放熱性が維持され、高 温環境下においても所定のダイオード容置が確保される **端子ボックスを提供せんとする。**

【解決手段】 バイパスダイオードとして薄型ベアチッ プロを用い、それぞれ中継端子に固着され且つ互いに対 向して中継端子間に延出する二枚一組の導電性金属薄板 の重合部31に前記薄型ベアチップを挟装してなるバイ パス回路構成体?を備え、当該バイバス回路に所定の必 要電流量が通電する際、少なくとも(A)日光。瓦温度 等の影響に基づくベアチップ周韶温度の変化、(B)通 電による発熱に基づくベアチップの自己温度上昇、

(C)上下電極層に接合している各導電性金属薄板を介 した熱伝導に基づくベアチップの放熱温度降下、の各温 度変化要素を総合したベアチップの表面温度が熱酸境温 度以下となるように、各導電性金層薄板における断面清 及び電極層に対する接合面積をそれぞれ設定してなる。



【特許請求の節囲】

【詞求項1】 太陽電池の出力取出用電極材が挿道される挿道口を有した筐体の内部に、前記電極材が電気的に接続される接続部を備えた複数の中継端子、及びこれち中継端子間に接続される単又は複数のバイパスダイオートを配数した太陽電池モジュールの出力部を構成する幾子ボックスであって、前記バイパスダイオートとして薄型ベアチップを用い、それぞれ申継端子に固君され且つ互いに対向して前記中継端子間に延出する二枚一組の準電性金属薄板の重合部に前記ペアチップを挟続してなる10バイパス回路構成体を備え、当該バイパス回路に所定の必要電流量が通電する際、少なくとも下記(A)~(C):

- (A) 日光、瓦温度等の影響に基づくベアチップ周囲温度の変化
- (B) 通常による発熱に基づくペアチップの自己温度上 昇
- (C)上下電極層に接合している各級電性金属薄板を介した熱伝導に基づくペアチップの放熱温度降下の各温度変化衰素を総合したペアチップの表面温度が終 20 破城温度以下となるように、各導電性金属薄板における断面積及び前記電極層に対する接合面積をそれぞれ設定してなる蝎子ボックス。

【記求項2】 温度変化要素(B)と温度変化要素(C)を総合したバイバス回路通電時のペアチップの表面温度変化が、電流費1A当たり170以下の温度上昇である請求項1記載の繼子ボックス。

【請求項3】 バイパスダイオードを配設した後、筐体内部にポッティング材が注入される端干ボックスであって、温度変化浸素(C) に前記ポッティング材による検 30 伝導を考慮してなる請求項1又は2記載の幾子ボックス。

【請求項4】 前記ポッティング材としてシリコン樹脂を用いた請求項3記載の端子ボックス。

【語求項5】 前記導管性金属薄板が銅板である語求項 1~4の何れか1項に記載の幾子ボックス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の居する技術分野】本発明は、太陽光発電ンステムに好適な太陽電池モジュールの出方部を構成する過子ボックスに関する。

[0002]

【従来の技術】近年普及している太陽光発電システムは、住宅等の屋根の上に配列設置される複数の太陽電池モジュールから構成され、図17に示すように、所定個数の太陽電池モジュール100、…をその裏面側出力部110を介して互いに直列接続し且つ当該直列接続の始端及び末端に位置する各太陽電池モジュールをそれぞれ屋内へ延びる引込みケーブル140、140に接続してなる直列一系統が多数連設されたものであり、屋内のイ

ンパータを通じて商用電力系統と選系し、屋内の電気配 銀に供給されるシステムが一般的である。

【0003】太陽電池モンュール100としては、図】8に示すように、太陽電池120、該太陽電池を支持する支持台130、太陽電池120の裏面側に設けた出力部110を構成する過子ボックス101、及び該端子ボックスより延出する互いに極性の異なる二本の出力ケーブル108、108より為るものがあり、各出力ケーブル106をそれぞれ前記支持台130の挿通灌130a及び図示しない禁側モジュールの挿道潜を介し軒側及び複側に延出させることで、隣接する他のモジュールの出力部又は上記した引込みケーブル140に接続されている。

【00,04】これら太陽離池モジュールの出力部を構成する端子ボックス101は二特闘平11-026035 号公報にも関示されている如く、例えば図19に示す内部構造を有している。

【0005】すなわち、太陽電池裏面側に当接する底壁 152の所定部位において当該太陽電池の裏面側に突踱 した出力取出用電極材を挿通するための特通口105 a を備えた鎖状の筐体105内部に、二個の中機端子10 4、104が左右対称で配置され、各中機端子104の 基端側には筐体外部へ延出する上記出力ケーブル106 が接続されている。各中機端子104、104の間には バイパスダイオード102が接続され、太陽電池を構成 する複数のセルの一部が影になっているときや夜間など に、該モジュールへ逆方向電流が流入することを未然に 阻止するバイパス回路が構成されている。

[0006] 【発明が解決しようとする課題】ところで、中継端子1 04.104間に接続されるパイパスダイオード 102 は、従来から樹脂紂止によりバッケージングされた汎用 のダイオードが用いられており、中鉄端子104との具 体的な接続形態は、該バッケージング内でダイオードの 電極層にワイヤボンディングした導電性の細線と、これ に連接して中継端子104に直接はんだ付されるリード. **級121を介して行われているが、住宅等の屋領上に設** 置される太陽電池モジュールの裏面側では、昼夜や季節 等の変化による温度差が約+40℃~90℃と大きく、 夏の昼間では80℃を超える高温環境となるため。 のような接続形態のパイパスダイオードでは、該ダイオ ードに発生した熱を細線及びリード領を通じて充分に放 熱させることができず、特に高温環境下においては、期 待されるダイオードの特性が確保されず、必要なバイバ

6有していた。 【0007】本発明は係る頻視に組み為されたものであり、バイパスダイオードの放熱性が維持され、高温環境下においても所定のダイオード客置が確保される端子ボ

ス機能が発揮されないばかりか、上昇した熱エネルギに

よりダイオードが断線着しくは破壊されるといった問題

特闘2001-168368

(3)

ックスを提供せんとするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は前述の課題を解決するにあたり鋭意検討を造めた結果、障型ベアチップのバイパスダイオードを各導電性金属薄板の間に挟装することで、当該ベアチップと導電性金属薄板との間に充分な接触面積が維持され、ベアチップに生じた熱が導電性金属薄板を通じて速やかに放熱されること、及び前記率電性金属薄板の断面積及び前記接触面積を適宜設定することで、夏場等の高温環境下においてもベアチップ19に所定の必要電流置が通電可能となり、バイパス機能を確実に維持できることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0009】すなわち本発明は、太陽電池の出力取出用電極村が挿通される挿通口を有した管体の内部に、前記電極村が電気的に接続される接続部を備えた複数の中継端子、及びこれら中継端子間に接続される草又は複数のパイパスダイオードを配設した太陽電池モジュールの出力部を構成する端子ボックスであって、前記パイパスダイオードとして薄型ペアチップを用い、それぞれ中継線 20子に固者され且つ互いに対向して前記中継端子間に延出する二枚一組の導管性金属薄板の宣合部に前記薄型ペアチップを挟続してなるパイパス回路構成体を備え、当該パイパス回路に所定の必要電流置が追離する際、少なくとも下記(A)~(C):

- (A)日光、瓦温度等の影響に基づくベアチップ周圍温 度の変化
- (B) 通電による発熱に基づくペアチップの自己温度上 点
- (C)上下電極層に接合している各準電性金属薄板を介 30 した熱伝導に基づくペアチップの放熱温度降下 の各温度変化要素を総合したペアチップの表面温度が熱破場温度以下となるように 各導電性金属薄板における 断面債及び前記電極層に対する接合面債をそれぞれ設定してなる婚子ボックスを提供する。

【0010】このような端子ボックスは、中継端子間に延出する導電性全層滞板の重合部に薄型ペアチップのバイバスダイオードを挟張した構成であるため、前記ペアチップに発生した熱は、上下管極層に接合している導管性金属滞板等を介した熱に導により息やかに放烈されるとともに、上記(A)~(C)の各温度変化要素に基づいて導電性金属薄板の断面積及び接合面積が設定されているため、端子ボックス設置環境の急激な温度変化にも摘らず、前記導電性金層薄板を介した優れた放熱性が維持され、バイバス回路に必要電流費を通電するペアチップのバイバス機能が確実に維持される。

【0011】CCで、温度変化要素(B)と温度変化要素(C)を総合したバイバス回路通電時のベアチップの表面温度変化が、電流費1A当たり17で以下の温度上昇である場子ボックスでは、夏場等の高温環境下におい 50

ても充分なバイバス機能が維持される。

【0012】また、バイバスダイオードを配設した後、 室体内部にボッティング材が注入される線子ボックスで あって、温度変化要素(C)に前記ボッティング材による 熱に導を考慮してなる端子ボックスでは、該ボッティ ング村を運じた放熱作用が加算されるため、温度変化要 素(C)のペアチップの放熱温度降下が大きくなり、特 にボッティング村として熱に導性に優れたシリコン樹脂 を用いれば、より効果的である。

【 0 0 1 3 】さらに、前記導電性金属薄板として熱伝導 率の大きい銅板を用いれば、温度変化要素 (C) である 当該導電性金属薄板を介したペアチップの放熱温度降下 が大きくなる。

.[0014]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施形態を添付図面。 に基づき詳細に説明する。図1は、本発明における太陽 電池モジュール出力部10の全体構成を示しており、図 1~14は本発明に係る端子ボックスの代表的実施形態 を示し、図中符号1は端子ボックス、2はベアチップ、 3 a. 3 b は導電性金属薄板をそれぞれ示している。 【0015】本発明に係る端子ボックス1は、図1及び 図2に示すように、太陽電池の出力取出用電極材、例え は、太陽電池のプラス電極とマイナス電極にそれぞれ結 級した二本のリード級が挿通される挿通□5 a を有する 筐体5の内部は、前記電極材がはんだ付等の接合手段に よって電気的に接続される接続部4.1を備えた複数の中 組織子4、4、並びに、これら中継端子4、4間に接続 されるバイバスダイオードを配設した太陽電池をジュー ルの出力部10を構成する端子ボックス1であって、バ イバスダイオードとして藤型ペアチップ2を用い、それ ぞれ中継幾子4に固着され且つ互いに対向して中継幾子。 4. 4間に延出する二枚一組の導電性金属薄板3a、3 りの重合部31に、前記ペアチップ2を挟装してなるバ イバス回路構成体7.を備えることで、ベアチップ2に発 生した熱が、該ベアチップに対し広範囲な接触面積を有 する認識性金属競板3-8、3 bや中継端子4等を通じた 熱に導により遠やかに放熱され、原に、図3の簡略図に ・示する導電性金属薄板3a.3hの断面積5、及び前記 電便層に対する接合面積S,を以下に示すように設定す ることで、蝎子ボックス設置環境の急激な温度変化にも 拘らず、前記導電性金属薄板3a、3bを介した優れた。 放熱性が維持され、バイバス回路に必要電流費を通電す。 るベアチップ2のバイバス機能が確実に維持された幾子。 ボックスである。

【0016】すなわち、本発明における導管性金属薄板3a(3b)の断面積S。及び接合面積S。は、バイパス 回路構成体7で形成されるバイパス回路に所定の必要管 流量が通常した場合に、少なくとも下記(A)~(C):

50 (A)日光、瓦温度等の影響に基づくベアチップ周囲温

(4)

特闘2001-168368

度の変化

(B)通常による発熱に基づくベアチップの自己温度上 昇

(C)上下電極層に接合している各導質性金層薄板を介した熱伝導に基づくベアチップの放熱温度降下の各温度変化要素を総合したベアチップ2の表面温度が、当該ベアチップ2の熱酸壊温度以下となるように設定される。

【0017】温度変化要素(A)のベアチップ周囲温度は、太陽電池モジュールが稼動しており且つバイバス回 19路が非通電状態のときのベアチップ表面温度であり、上記日光及び瓦温度の影響以外に、気温や、筐体を含む選子ボックス各部の素材特性、構造、太陽電池モジュールの動作温度等に影響を受ける。

【0018】温度変化要素(B)の自己温度上昇は、太陽電池モジュールの容費等に応じて適宜選択される個々のベアチップの発熱特性に基づくものである。

[0019] 温度変化要素(C)の放熱温度降下は、ペアチップ2の上下弯極層に接合される各導電性金属薄板3a.3bを介した熱伝導に基づくものであり、導電性20金属薄板3a.3bの熱伝導率、比熱、筋面積Si、接合面積Si、長さ上等により特定される。

【0020】そして、温度変化要素(B)と温度変化要素(C)を総合したバイバス回路通電時におけるベアチップ2の表面温度変化は、当該ベアチップ2の発熱量、前記導電性金属薄板3 a 3 b その他部材の熱伝導率、比熱等を用いた層知な熱伝導の微分方程式に基づく解析的方法や、差分法、有限要素法等の数値解法、その他の解法により予測することが可能であり、この表面温度変化が、電流量1 A当たり17で以下の温度上昇となるような上記断面積5、接合面積5,を設定することで、夏場等の高温環境下においても充分なバイバス機能を維持する端子ボックスが構成されるのである。

【0021】以下に各部の構成を更に詳しく説明する。 【①022】中継過子4は、平面視略長方形状の長尺な 金属製板状部村で構成されており、筐体底部の挿道口5 8 に貼む先端側43 に余備はんだが上面に添着される接 総部41を設け、且つ、他方の基礎側44に芯線をカシ メ止めすることで出力ケーブル6を接続した後、図4に 示すように、筐体底壁52から上方に突設した取付け突 40 起93及び位置決め突起94を、対応する取付け孔4 5. 46にそれぞれ挿通した上、取付け突起93に圧着 リング14を練着することで、当該中継過子4を底壁5 2に係止するとともに、出力ケーブル6、6は、管体底 部から当該出力ケーブルの延出方向に沿って突設されて いる国定基台56とこれに上方から嵌合する固定部材5 7との間に挾姫した上、前記固定基合56、固定部材5 7及び出力ケーブル6、6の外皮を互いに超音波溶音で 筐体5と一体に固定することにより、前記中継端子4と 共に管体5内部に配設される。

【0023】尚、中継端子4と出力ケーブル6との接続手段は、前記カシメ止めした上から更にスポット溶接を施すことや、出力ケーブルを中継端子にネジ止めすることも好ましく。また、中継端子4を管体5内部に配する手段は、前記圧着リング「4の代わりに取付け突起93先端を超音波等で溶融して大径化することや、ネジ止めすることも好ましく、また、出力ケーブル6を管体5に固定する手段は、該ケーブルを挟続した固定基右56及び固定部材57をネジ止めすることや、クランブにより直接登体に固定することも好ましい。

【0024】出力ケーブル6、6の先端には、ブラグ若しくはソケットを内装した防水コネクタ61、62が設けられており、これら出力ケーブル6、6は前記防水コネクタを介して開接する太陽電池モジュールの出力ケーブル又は引込みケーブルに結場される。

【0025】

「関えば、N型シリコンウェハの表面に拡散処理によりP型層を形成し、表面に格子状の凹溝をエッチング形成して、該凹溝に現出しているPN接合部にガラスパシベーションを施した後、該凹溝を回設されたダイオード素子及びウェハ裏面に電配層を形成するとともに、該凹溝に沿って複数に分離して得られるメサ型ダイオードチップが用いられている。この薄型ペアチップのPN接合部における接合部温度は約150℃で、この接合部温度が当該ペアチップ2の熱酸壊温度となる。したがって、バイパス回路構成体7の作製に除しては、各導電性金属薄板3a、3bの断面積及びペアチップ上下の電極層に対する接合面積を、上述の各温度変化衰素(A)~

(C)を総合したベアチップの表面温度が150℃以下となるように設定するのであり、本実総形態では、図5に示すように、周囲にガラスパシベーション屋を被覆した薄型ベアチップ2の上下各層極層の略全面にわたって、無限素銅からなる厚み約0.2mmの各導電性金属薄板3a、3bの一端側がそれぞれ接合され、二枚一組の抑電性金属薄板3a、3b及び薄型ベアチップ2からなるバイパス回路構成体7が筐体外で迅速且つ距実に構成される。尚、各導電性金属薄板3a、3bは、銅以外に熱任導性に優れたアルミニウムや、金、銀の単体又は合金が好適に使用できる。

10 【0026】各電極層の形状は、アノード電極側が2. 45×2. 46 mm、カソード電極側が2. 7×2. 7 mmの略正方形で、これら電極層に接合される各導電性金属競板の宣合部における帽は、アノード電極側の薄板3 a が2. 3 mm、カソード電極側の薄板3 b が4. 0 mmで、クリームハンダ等のろう接合金8を介し、それでれ電極圏の略全面を保持しており、アノード電極側の接合面積5,が約5. 6 mm'、カソード電極側の接合面積が約17.3 mm'にそれぞれ設定されている。

【0027】このように、導管性金属薄板3a、3bと 50 その重合部31に挟装した薄型ペアチップ2のバイパス

/ 1

ダイオードとから構成されるパイパス回路構成体では、上述の優れた放熱性以外に、制脂対止されていない分、従来のパイパスダイオードに比べて藤内となり、筐体をよりコンパクト化できるといった効果を奏している。ただし、本発明はこのような構造に限定されるものではなく、単合部31の周囲を樹脂対止でパッケージングしておくことで、当該パイパス回路構成体の組み付け時の作業性や放熱性をさらに高め、且つ、後述の保護リブと同様、確型ペアチップ2のパイパスダイオードに、はんだこて、工具その他の物体が直接当たり、熱ダメージや破り、

【0028】上記中継總子4、4を配設する限に、位置 決め突起94が挿通される取付け孔46は、何れか一方 の中継端子4の長季方向中央部に対して基端側44番り に穿設されており、既にこれら中継端子4、4並びに出 力ケーブル6が配設された筐体5内に、バイパス回路構成体7を組み付ける際には、図6に示す如く、前記取付け孔46を頁通して中継端子4上方へ突出した位置決め 疾起94を、一方の導管性金層薄板3bに穿設される位 置決め孔34に係合することで、中継端子4、4の上面 間に位置決めされた状態で容易且つ迅速に綺護され、且 つ各等管性金属薄板3a、3bを中継端子4の上面には んだ付で固者することで、中継端子4、4の各基地雷 りに接合される。

【0029】バイバス回路構成体7における導電性金属 薄板3a、3bの側縁部には、筐体5の底壁52から当 該導電性金属薄板3よりも上方に起立する彼数対のリプ 9.…が当該側縁部に沿って付設されており、詳しく は、図2に示したように、各導電性金属薄板3a、3b 30 の端側71a、71b両側縁に沿って付設した二対の規 制リブ91a、91b、並びに、ベアチップ2が決壊されている倉台部31両側縁に沿って付設した一対の保護 リブ92が、それぞれ付設されている。

【9030】ととで、規制リプ91a、91bは、バイパス回路模成体でを中能端子4、4の上面間に橋渡しする際、当該リプ間に導管性金属薄板3の端側で1a、71bをそれぞれ統入するととで、該導電性金属薄板3の位置決め手段として機能し、当該バイパス回路構成体での組み付け作業を容易且つ迅速にするものであり、さらに詳しくは、一方の導管性金属薄板における重合部を構成しない端側で1aに、中継塩子4の外側に延出する極狭部35を予め形成しておき、該幅狭部35をとれに対応する規制リプ91aの間に挟入することで、橋渡し方向を誤ることなく組み付けできる。

【0031】また、保護リブ92は、同じくバイバス回路構成体7を中継過子4、4の上面間に循環しする際、 当該リブ間に重合部31を統入することで、循環したバス回路構成体7と中継端子4との接合、または後述の出力取出用電価材と中継端子4との接合に用いるはん 50 立てが完了される。

だこて等の加熱手段が重合部31に直接接触することや、当該バイバス回路構成体7を筐体内に組み込んだボックス本体11を移送する際、工具その他の物体が重合部31に直接衝駆を与えることなどを回避し、バイバスダイオードの熱ダメージや衝撃による破損を未然に防止するものである。

【0032】尚、筐体内には、規制リブ91a、91b 及び保護リブ92以外に、他のリブを設けても良いが、 これちリブは、前記パイパス回路模成体その他の部材と 筐体底壁との間などにポッティング村が段間なくスムー ズに充填されるよう、導電性金属薄板3a、3bの延出 方向、すなわち規制リブ91a、91b又は保護リブ9 2に対して平行に設けておくことが好ましい。

【00033】管体5の内部に設けるバイバスダイオードの個数は、太陽電池モジュールの容量等に応じて適宜決定され、例えば二つのバイバスダイオードを中継端子4、4間に並列接続するときには、図7に示すように、当該中継繼子4、4の上面間に上記したバイバス回路機成体7を二本隣接して平行に設護しまつ接合すれば良い。とのように複数のバイバス回路構成体7を並列接続すれば、通電時の電流置が分散され、上述した温度変化要素(B)の各ペアチップの発熱による自己温度上昇を抑えることが可能となる。

【0034】また、バイバス回路模成体7を模成している各導電性金属薄板3a.3bは、扁平な板状体で且つ長手方向に略真直な形状を有しているが、昼夜等の温度変化と起因する熱膨張により前記導電性金属薄板が伸縮を繰り返し、その宣合部31に挟続した薄型ペアチップ2のバイバスダイオードに大きな剪断力が生じる可能性があるため、特に中職場子4、4間の解問距離が大きく、各導電性金属薄板3の延出寸法が大きくなる場合には、図8の(a)、(b)に例示するように、該導電性金属薄板3a.3bの延出方向に沿った全体又は一部に、適曲した部位32又は屈曲した部位33を設けたものも好ましい。

【0035】本実施形態に係る過子ボックス」は、 筐体 5の上端閉口部53に嵌装される蓋体51を備えており、上記の如く、中継幾子4、4の上面間にバイバス回路構成体7を構渡し且つ接合してなるボックス本体11は、 挿通口5aを介して出力取出用電極材を筐体内部に挿通した状態で、ネジや接着削減、 粘着削等により太陽電池裏面側に固定され、 前記電極材を中継過子4の接続部41に接続した後、 図9に示すように、これら電極材12、バイバス回路構成体7、及び中継端子4、4が収装され且つ隔壁54で開続された筐体内の所定空間55に、エボキシ樹脂やボリウレケン、シリコン樹脂等からなるボッティング材13を注入、充填することで、各部材及びその接続部分を気密に対止した上、 前記整体51により上端閉口部53を閉塞して過子ボックス1の組み立てが完了される。

[0036] 前記ボッティング村13は、筐体5の内部に配する各部村及び接続部分を気容に対止することで、湿気や雨水、埃等の浸入を防ぎ、その腐食や劣化。 筒撃による破損を防止しつつ絶縁性を維持するものであり、前記ボッティング村として特に熱伝導性に侵れたものを採用すれば、重合部31の上下に充填される当該ボッティング村を通じて、ベアチップ2の放熱性をより高めることができる。

【0037】そして、このような鑑子ボックス1においては、図10に示すように、ベアチップ2で発熱した熱 10が、ベアチップ2の上下電極層に熱接触している響管隆金属薄板3 a、3 b、各薄板3 a(3 b)に熱接触している中報鑑子4とボッティング材13、及びこれに熱接触している出力ケーブルや管体5を伝熱部材とした熱流 路を仮定することで、上途した温度変化要素(B)と温度変化要素(C)を総合してなるバイバス回路道電時のベアチップ表面温度が予測できるのである。

【0038】尚、上記ポッティング村13は必ずしも必要ではなく、この場合には図11に示すように、ベアチップ2で発熱した熱が、ベアチップ2の上下電便層に熱 20接触している導電性金層療板38、3b、各薄板38

(3b) に熱接触している中継端子4及び各中継端子4 に熱接触している出力ケーブルや筐体5を伝熱部付とし た熱流路を仮定することで、同じくベアチップ表面温度 が予測できる。

【0039】また、中継端子間に延出した二枚一組の夢電性金屑薄板3.3及びその宣合部31に挟装された薄型ペアチップ2のバイバスダイオードからなるバイバス回路構成体7は、筐体底壁52より上方に浮いた状態に設けられているが、本発明はこのように下方に空間を設けた構造に限定されるものではなく。図12に示すように、薄型ペアチップ2を挟装している重合部31の下面を筐体底壁52に密君させ、該底壁52を通じて放熱性の向上を図るものも好ましい。この場合、導管性金属薄板3aから筐体底壁52への熱流路が追加され、ペアチップの放熱効果が向上する。

【0040】端子ボックスの他の例として、例えば図】 3及び図14に示すように、前記中継端子4に出力取出 用電極材12を接続する接続部41. 導電性金廃棄板3 を固着する固着部及びその近傍部を除いた当該中継端子 4全体と、該中継續子4の基準側に接続され、筐体5外 部に延出する出力ケーブル6とを、筐体5と一体的に成 形してなる蝸子ボックス1、も好ましく、筐体底壁53 にはボッティング材の充填により気密に対止すべき接続 部41及び固着部を囲続する隔壁54、が立設されている。

【0041】このような端子ボックス1 のボックス本体11は、筐体5を成形する際に、中継端子4とこの基端側に既に接続した出力ケーブル6とを金型内にインサートして、当該筐体5と一体的に射出成形して作製さ

れ、上述の過子ボックス」において必要な中継端子4及び出力ケーブル6を関体に固定するための取付け突起93や取付けれ45、圧者リング14、固定部材57等が不要となり、部品点数が少なく組立工程が簡略化されるとともに製造コストが大幅に低減される。また、隔壁54、で開焼される空間は、上述の過子ボックス1の隔壁54で開焼される空間55に比べ、中継過子基端側44における出力ケーブル6との接続部分を含まない分だけ小さくなり、充填するボッティング村の使用費も低減されるのである。

[0042]

【実緒例】次に、本発明に係る遮子ボックスと従来の遮 子ボックスとを比較する。...

【0043】実施例1は上記代表的実施形態に示すように、メサ型ペアチップPTD27K(パワード有限会社製)の上下電極層の略全面に厚さり、2mmの銅板3a 3bをそれぞれ接合したバイパス回路構成体7を備え、内部にボッティング村としてシリコン樹脂を封入した端子ボックス1、実施例2は、同じくバイパス回路構成体7を備え、内部にボッティング村を封入しない過子ボックス1、比較例1と比較例2は、それぞれ10A、20A用のバイパスダイオードFSF10A60、FSKF20A(何れも日本インター株式会社製)を用いた図19に示す従来からの過子ボックス101である。

【0044】図15は、実施例1及び実施例2の各場子ボックスにおいて、ベアチップに通電される電流量と、そのときにベアチップの表面で裏測される上昇温度との関係を示すグラフであり、上述の温度変化要素(B)及び(C)を総合したベアチップ表面温度変化の実測値に基づいている。図16は、上記実施例1、実施例2、比較例1、比較例2の各場子ボックスにおいて、周囲温度と該周囲温度で通電可能な電流置との関係を示すグラフである。

【0045】図15のグラフから分かるように、本発明に係る実施例1の鑑子ボックス1は電流登1A当たり約11℃の温度上昇、実施例2の鑑子ボックス1は電流登1A当たり約14℃の温度上昇で、同れも上昇温度17℃以下を満たしている。また、鑑子ボックス内部化シリコン樹脂を封入した実施例1が、封入していない実施例2に比べて温度上昇が抑制されており、シリコン樹脂の一封入でベアチップの放熱が促進されることが分かる。

【0046】そして、図16のグラフによれば、周囲温度が80~90℃以上となる夏場等においては、比較例1のバイバスダイオードに流れる電流量が約1.07A以下、比較例2のバイバスダイオードに流れる電流置が約1.37A以下となり。充分なバイバス機能が維持されないのに対し、衰施例1のペアチップでは、周囲温度が約107℃で電流置4A、衰施例2のペアチップでは、周囲温度94℃で電流量4Aが確保され、周囲温度90℃以上となる高温環境下においても充分なバイバス

特闘2001-168368

機能を発揮するととが分かる。

[0047]

【発明の効果】請求項1記載の選子ボックスによれば、 中継端子間に延出する導電性金属薄板の重合部に薄型べ アチップのバイバスダイオードを挟続した構成であるの で、前記ペアチップに発生した熱が、上下電極層に接合 している導電性金属薄板等を介した熱に導により遠やか に放熱されるとともに、当該バイパス回路に所定の必要 電流量が通電する際、常にバイバス回路が機能するよう に導電性金属薄板の断面積及び接合面積が設定されてい 10 るので、過子ボックス設置環境の急激な温度変化にも鉤 らず、ベアチップのバイバス機能が確実に維持される。 【0048】請求項2記載の幾子ボックスによれば、バ イバス回路通電時の薄型ベアチップの表面温度変化が、 電流量1A当たり17℃以下の温度上昇であるので、夏 場等の高温環境下でも充分なバイバス機能が維持され る.

・【0049】請求項3記載の蝎子ボックスによれば、ボ ッティング材を通じた放熱作用が加算されてベアチップ の放熱温度降下が大きくなるので、例えば導電性金属障 20 板の断面積をより小さくすることで端子ボックス全体の コンパクト化を図ることも可能となる。

【0050】請求項4記載の蝎子ボックスによれば、前 記ポッティング付として熱圧導性に優れたシリコン樹脂 - <u>を用いているので、</u>前記ベアチップの放熱温度降下がよ り大きくなる。

【0051】請求項5記載の幾子ボックスによれば、前 記導電性金属藥板として熱促導率の大きい銅板を用いて いるので、当該導電性金属薄板を介したベアチップの放 熱温度降下が大きくなり、同じく過子ボックス全体のコー ンパクト化を図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の代表的実施形態に係る幾子ボックス及 び出力ケーブルから構成した出力部の全体構成を示す斜 视家。

【図2】同じく無출状態の端子ボックス及び出力ケーブ ルを示す説明図。・

【図3】バイバス回路模成体における各導電性金灰薄板 とペアチップとの接合要部を示す分解説明図。

【図4】 筐体内に中継端子及び出力ケーブルを組み付け 40 ・る様子を示す説明図。

- 【図5】 端子ボックス内部のバイバス回路構成体を示す 護明[]

【図6】中継端子の上面間にバイバス回路機成体を組み 付ける様子を示す説明図。

【図7】中継端子の上面間にバイパス回路機成体を二本 隣接平行に橋架した例を示す説明図。

【図8】(a)及び(b)は、それぞれバイバス回路模 成体の変形例を示す説明図。

【図9】 嶋子ボックスを太陽電池に取付けた状態を示す 50 121 リード線

說明断面図。

(7)

【図10】ベアチップで発生した熱を放熱する各伝熱部 材を示す説明図。

【図11】ボッティング村を充填しない越子ボックスの 例において、ベアチップで発生した熱を放熱する各伝熱 部村を示す説明図。

・【図12】 薄板重合部の下面を筐体底壁に密着させた端 子ボックスの側において、ベアチップで発生した熱を放。 熱する各伝熱部村を示す説明図。

【図13】蝎子ボックスの変形例を示す斜視図。

【図14】同じく無蓋状態の幾子ボックス及び出力ケー ブルを示す説明図。

【図15】ベアチップに通電される電流置と、そのとき にベアチップの表面で実測される上昇温度との関係を示 すグラフ。

【図16】周囲温度と該周囲温度で通常可能な電流量と の関係を示すグラフ。

【図17】屋根上に配列設置される太陽電池モジュール を示す説明図。

【図18】太陽電池モジュールの出力部を示す説明図。 【図19】従来の繼子ボックスの内部構造を示す説明 **3**

	【符号	号の説明)		
	1.	1	1.0	出力部
	1 1	ボックス本体・	12	電極材
	13	ポッティング材	14	圧着リング
	2 -	ベアチップ	За,	3 b 薄板
	31	重台部	32	湾曲した部位
	33	屈曲した部位	34	位置決め孔・
)	35	幅狭部	4 d	4維端子
	4)	接続部	4.2	上面 :
	43	先變例	44	基端側
	45	取付け孔	46	取付け孔。
	5 2	登体	5 a	挿道口
	`5·1	萱体	52	虚望
	53	上雄関口部	54,	54: 陽壁

55 空間 5.6 固定基台

57 固定部柱 6 出力ケーブル

61 防水コネクタ 62 膀水コネクタ 7 バイバス回路機成体 7 Fa. 7 Ib 端側

8 ろう接台金

9 リブ

93 取付け突起

91a、91b 規制リブ 92 保護リブ 9.4 位置決め突起

S. 断面積

S。 接合面箱

100 太陽電池モジュール

101 総子ポックス

102 バイバスダイオード

104 中継端子

105a 挿通口 120 太陽電池

130 支持台

105 筐体

11

